

技术参数

5611LB

日期：08/2023

应用

特点

单组份环氧树脂胶粘剂，低粘度流动性好，固化速度快，加热易返修，具有良好的助焊剂兼容性；适用于微电子表面贴片领域的底部填充；

粘接材料

金属，陶瓷，玻璃，塑料；PCB，FPCB

典型应用

CSP&BGA 底部填充，尤其适用于微小缝隙及 FPC 柔性电路板底部的填充；

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂胶粘剂	
外观	黑色液体	
粘度	342 cps	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件	30mins@100°C 10mins@120°C 5mins@150°C	
闪点	>500F	
比重	1.158 g/cm ³	ASTM D-1875

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色固体	
邵氏硬度	89D	ASTM D-2240
玻璃化温度	84°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
工作温度范围	-55°C—150°C	

储运条件

使用方法

点胶，浸蘸，喷涂；

储存方法

-20°C 冷冻保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少解冻 2 小时，250ml 包装解冻不少于 4 小时；

有效期

6 个月

包装

30ml 针筒装，55ml 针筒装，250ml 瓶装

注：

1. 本技术数据表 (TDS) 中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号





技术参数

试，并以此来评估确认该产品的适用性。

2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

